

ChaMP

ACCRETECH CMP TOOL

ACCRETECH-CMP でお役に立てます

半導体先端デバイス製造工程及びウェーハ製造工程で長年蓄積してきたノウハウを活かし、CMP 加工における各種プロセスサービスを提供しております。

また、お客様デバイスの一部工程（研磨・洗浄）を受託生産するファウンドリサービスもお受けしております。量産デバイスに求められる洗浄品質も、ご相談に応じて保証可能です。

※開発から量産までを豊富な技術と経験でトータルサポートいたします。

お客様のすきまを、あらゆる観点からサポートさせていただきます

- プロセスサービス
- ファウンドリサービス
- CMP装置販売
 - ・ R&D向けCMP装置
 - ・ 量産向けフルオートCMP装置
- CMP消耗品提案、販売

～ まずはお気軽にご相談ください。～

提供サービス

■ プロセスサービス

- ・ 新規CMP工程導入における選定サポート、コストダウンのご提案
- ・ 適用済みプロセス見直しによるコストダウンのお手伝い（消耗品評価を含む）
- ・ 弊社高性能研磨ヘッドとの組み合わせによる歩留まり改善
- ・ 研究開発、試作デバイスのCMP加工、プロセス提供
- ・ 各種膜厚測定 ・ シート抵抗測定 ・ 段差測定 ・ 表面粗さ測定 ・ 異物検査 他

■ ファウンドリサービス（CMP加工・洗浄）

- ・ 表面粗さ改善 ・ 段差解消、緩和 ・ 表面改質
- ・ 膜厚制御 ・ 埋め込み配線化研磨
- ・ 超精密洗浄 他

■ CMP用途例

- ・ Siウェーハ 異種材料基盤上の堆積膜研磨として（Cu配線・STI・ILD他）
- ・ 樹脂材料やセラミック材料等の表面粗さ改善として
- ・ 基盤貼り合せ面の表面粗さ改善として
- ・ TSVやMEMS、SOI向けCMP加工にお役立てください

CMPは研磨対象を選びません。まずご相談ください！！

CMP トータル・ソリューション提供

試作・開発サポート ▶ R&D向けCMP装置 ▶ 量産向けCMP装置

○プロセスサービス

プロセス設計から提供できます。
お客様の需要にあわせ、各種設備
の提供が可能です。
プロセスは一環共通化できます。

○研磨部仕様は統一

- ・研磨ヘッド
- ・プラテン機構
- ・コンディショニング
- ・各種オプション

プロセスはもちろん、選定後の消
耗品も一環共通化可能。

○ファウンドリサービス

少量からの Lot 生産に対応いたし
ます。
同一プロセス・品質の生産対応で、
市場のニーズ対応にお役立てくだ
さい。



ChaMP311
2" ~ 12" ウェーハ対応
□基盤対応



ChaMP232
4" ~ 8" ウェーハ対応
Dry In Dry or Wet Out 対応



ChaMP332M
12" ウェーハ対応
Dry In Dry or Wet Out 対応

試作・開発から量産までトータルでサポート可能です

About us...

■設備紹介

- ・Class 1000/10クリーンルーム
- ・各種薬液供給、洗浄装置
- ・膜厚測定機
- ・異物検査機
- ・AFM
- ・その他 精密計測機器、
環境測定機器完備
- ・2"~12"対応開発向け研磨加工機
- ・6"、8"、12"フルオートCMP装置
- ・シート抵抗測定機
- ・外観検査装置
- ・SEM/EDX



Class 10 測定エリア

株式会社東京精密 八王子第三工場 ※お問合せはこちらまで

〒192-0032 東京都八王子市石川町 2968-6

TEL:(0426)42-0381 (担当: CMP グループ 小宮山)

Mail:cmp_process@accretech.jp

[最寄り駅からのご案内]

1. 八高線「北八王子駅」下車徒歩 1 分
2. 中央線「日野駅」北口下車
・バス / 京王バス八王子駅北口行「コニカ・ミノルタ前」下車徒歩 12 分
・タクシー / 約 7 分 (約 3km)
3. 中央線「豊田駅」下車タクシー約 7 分 (約 3km)

